



## XP-1100A 無鹵素專用褪洗液

### 概 述

XP-1100A為一鹼性藥水，為PCB防焊油墨專用之褪洗液。XP-1100A可去除PCB用之各種感光油墨，並可去除基板表面及銅面上之大部分污垢，其中XP-1100A所添加之抗氧化劑，更可防止銅面上產生之氧化現象。

### 物 性

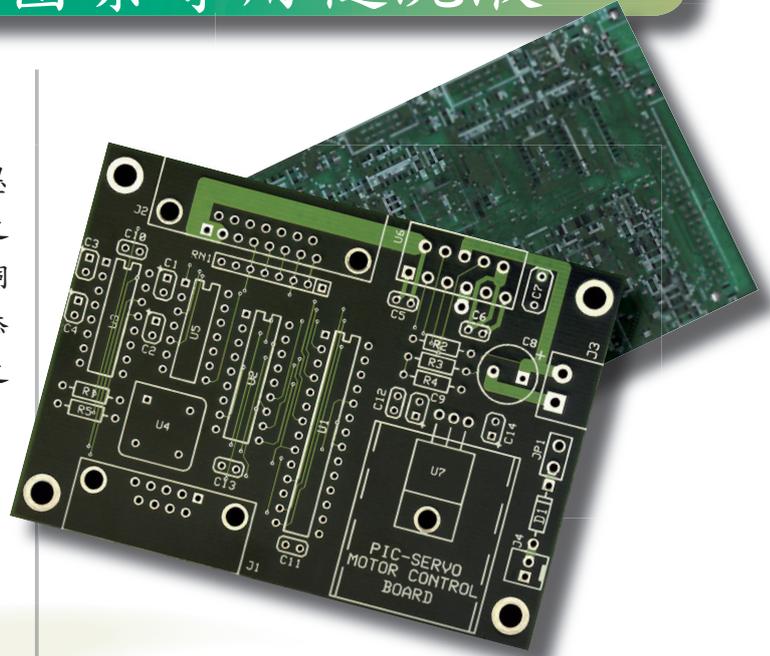
外 觀	無色透明液體~淡棕色
比 重	1.13 ± 0.1 (25°C)

### 特 性

1. 可有效去除孔內油墨。
2. 操作溫度較低節省操作相關成本及升溫時間。
3. 無燃點操作安全。
4. 與水完全相溶。
5. 藥效穩定可長期使用。

### 使用 方法

1. 以XP-1100A藥液原液配槽。
2. 將溫度設定為85°C。
3. 溫度到達後將待處理物件完全浸泡於XP-1100A藥液中。
4. 預烤之板材約處理3分鐘即可去除表面油墨，5分鐘即可去除孔內油墨。
5. 後烤之板材約處理20分鐘去除表面油墨，20分鐘去除孔內油墨。



### 注 意 事 項

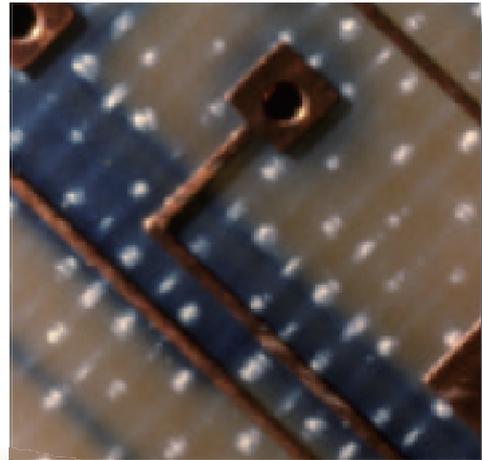
1. 表面處理務必徹底清潔方可作去除孔內油墨之浸泡。
2. 使用前宜參閱本公司之物質安全資料表。
3. 儲運溫度宜小於130°F (54°C)，請遠離活性金屬及酸性物。
4. 請穿戴耐鹼之防護具，如有噴霧情形或於密閉場所使用時，應戴有勞工局認可之呼吸具。
5. 務必小心添加少量本劑於攪動之冷水，切勿大量倒入水中。不用時應蓋緊封蓋。
6. 切勿與食品及碳酸飲料接觸，以免產生諸如一氧化碳之不良氣體。
7. 使用時宜求通風良好避免觸及眼睛皮膚及衣物切勿服用。



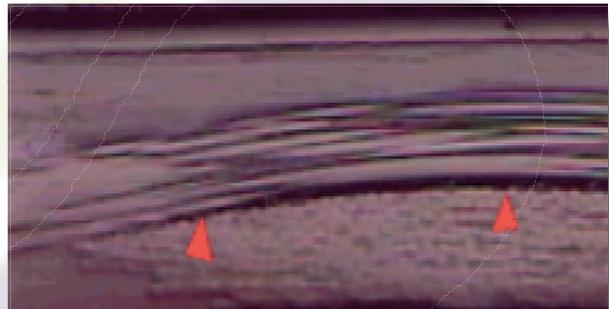
## 防焊褪洗與織紋顯露之關連

### 內容

目前的電路板用基板的主要樹脂是 bisphenol A型的溴化環氧樹脂，因為環氧樹脂本身除成本考量外，在耐燃性，電絕緣性，機械性，加工性及耐化學性等皆相當優越，而防焊感光形油墨的主要成份亦為環氧樹脂，是故在防焊褪洗重工製程中，織紋顯露的問題為首要注意事項。



基板的環氧樹脂與油墨的環氧樹脂因為製程方法上之不同，而有不同的特性呈現，大致上來說因基板的壓合製程是採高溫高壓形成，故在密度上遠大於印刷製程的防焊油墨，在密度高的狀況下，耐燃性，電絕緣性，機械性，加工性及耐化學性等皆有明顯的提升，而防焊褪洗就是利用此一不同特性來將油墨去除，並同時將織紋顯露發生的機會降到最低。



在褪洗溫度攝氏85度時1分鐘(依油墨不同條件有所差異)可去除後烤油墨0.05mil 而在相同條件下1分鐘可去除基板的環氧樹脂0.008 mil。

以下為不同溫度下之差異性：

	基 板	油 墨
85度	0.007 mil/min	0.05 mil/min
90度	0.008 mil/min	0.07 mil/min
95度	0.01 mil/min	0.09 mil/min